CLIPPEDIMAGE= JP361142430A

PAT-NO: JP361142430A

DOCUMENT-IDENTIFIER; JP 61142430 A

TITLE: TEMPERATURE DETECTOR

PUBN-DATE: June 30, 1986

INVENTOR-INFORMATION: NAME

SHIBUYA, KATSUJI ISHIKAWA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP59265723

APPL-DATE: December 17, 1984

INT-CL (IPC): G01K007/00;G01K007/22

US-CL-CURRENT: 374/208

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent infiltration of moisture from outside, by working the outside of the opening of an inner case housed in a metal case for electric insulation in a concave ring to seal.

CONSTITUTION: A concave-ring-shaped flange is formed outside the opening of an inner case 14. The filling and molding of a molding resin 16 into a metal case 11 are performed as being heated. The metal case 11 and a terminal 17 are molded in one-piece being held on a resin mold securely so that the inside of the inner case and the part of the opening formed in a concave ring will be filled sufficiently. Thus, as the part of the opening thus formed in a concave

02/27/2003, EAST Version: 1.03.0002

ring is filled sufficiently with the molding resin, a sealing can be made to keep moisture from infiltrating inside in the combination of material having any coefficient of thermal expansion thereby preventing deterioration in the electric insulation resistance.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

02/27/2003, EAST Version: 1.03.0002

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 142430

(i)Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)6月30日

G 01 K 7/00

7/22

A - 7269 - 2FC-7269-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 温度検出器

②特 昭59-265723

20世 願 昭59(1984)12月17日

渋 79発 明 者 谷 朥 治

敏男

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

79発 眀 者

四代 理

石 Ш

弁理士 中尾

夫

門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

70出 願 人 松下電器産業株式会社

外1名

1、発明の名称

温度検出器

2、特許請求の範囲

金属ケースの内部に樹脂インナーケースを備え、 その中にサーミスタ等のセラミック半導体素子を 収納し、外部に端子を引出した状態で成型樹脂を 充塡し、一体成型した温度センサで、インナーケ ースと充塡樹脂の接合部であるインナーケースの関 口部外側を凹環状形に加工したことを特徴とした 温度検出器。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は水,オイル等の液の温度を検知する温 度検出器に関するものである。

従来の技術

従来、との種の温度検出器は、第2図に示すよ **りな構造であった。第2図において、金属ケース** 1内にインナーケース4を挿入し、セラミック素 子2と端子でをリード線3を介してハンダ5及び

ハンダ8で接続したエレメントを、更にその上か ら挿入して成型樹脂 6 を充塡して一体成型されて v.t.

発明が解決しようとする問題点

しかし、このような構造のものでは金属ケース 1とインナーケース4及び成型樹脂6の材質が異 なると、各々の無膨張係数が異なるため一体成型 後金属ケース1と成型樹脂6の界面又はインナー ケース4と成型樹脂6の界面にすき間ができたり、 使用上の熱的環境変化で剝離する。従って、従来 構造のものを湿気の高いところや、屋外に露出し て使用すると環境の温度変化に伴なって湿気が前 述のすき間から浸入し、その湿気がリード線3又 はセラミック素子2にまで到達し、金属ケース1 と端子での間の電気絶縁抵抗を著しく劣化させる という問題があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、熱的な悪条件で使用しても絶縁劣化を起 こさせないようにするものである。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明は、前述の インナーケースと充填樹脂(成型樹脂)の接合部 であるインナーケース開口部外側を凹環状形に加 工したものである。

作用

この構成により、インナーケースと成型樹脂の 材質が異なり、熱膨張係数が異なっても凹環状形 に加工されたインナーケース開口部外側に設けた 凹環状形に加工した部分の内面又は外面でシール がとれ、使用上の熱的環境変化にも強く電気絶縁 の劣化は生じない。

つまり、インナーケースと成型樹脂の材質の比較にないて、インナーケースの材料より成型樹脂材料の方が熱膨張係数が大きい場合は、高温で充填成型された後冷却されてインナーケースの外面で芯方向に熱収縮して常に応力が加わった状態となりシールがとれる。又、逆に成型樹脂材料の方が熟膨張係数が小さい場合は、高温で充填成型後冷却されてインナーケースの凹環状形に加工された内面でシールがとれる。

で中継接続したものをセラミック案子12個から 挿入して樹脂成型金型にセットし、金属ケース内 に成型樹脂18を注入しながら充塡成型したもの である。充塡成型は加熱された状態で行なわれ金 属ケース11及び端子17は樹脂成型金型で確実 に保持された状態でインナーケースの内部及び開 口部の凹環状に加工された部分が十分に充填され るように一体成型したものである。

以上のように、開口部が凹環状に加工された部分に成型樹脂が十分充填されることによりインナーケースの材料と成型樹脂の材料の熱膨張ケースが異なってもインナーケースの凹環状加工部の内 周面でシールを保つ結果となり虚気が内部に浸入するのを防ぐこととなる。

即ち、インナーケースの材料の熱膨張係数より 成型樹脂の熱膨張係数が大きい材料を選んだ場合 は、高温で充塡成型された後冷却されて2つの材 料が同時に芯方向に収縮するが成型樹脂の方が収 縮度が大きいためインナーケースの外周面に収縮 の応力が常に加わりこの部分でシールをとる。又、 以上の結果、使用樹脂の熱変形温度以下での周囲の温度変化があってもインナーケースと成型樹脂の接合部にはすき間はできないため湿気の浸入もなく、電気絶縁抵抗の劣化は起こらないようになるのである。

実施例

以下、本発明の一実施例を添付図面にもとづい て説明する。

第1図において、11は外側に取付け用ネジを施こし、熱応答性を考慮して感熱部である先端部を細く加工した金属ケースで、その中に樹脂等の絶縁体で成型された底付きのインナーケース14 を挿入し、そのインナーケース14の開口部は外側に凹環状のツバが施こされている。しかもインナーケース14は感熱部(先端部)ではケース11内面に接して挿入されているが反対側で挿入される構造になっている。その上から、セラミック素子18と外部取出しのための端子17をリード線13を介してそれぞれハンダ18、ハンダ15

無膨張係数が逆で成型樹脂材料の方が小さい場合はインナーケースの凹環状加工部分の内周面に常に熱収縮の応力が加わりこの部分でシールをとる。従って本構造であれば、いかなる無態張係数を有する材料の組合せでもシールがとれ内部への湿気の浸入を防止し電気絶縁抵抗の劣化が生じない。

発明の効果

本発明は、金属ケース内に収納して用いる電気 絶縁のためのインナーケースの開口部外側に凹環 状の加工を施こしてシールをとることにより、外 部からの湿気の浸入を防ぐことができる。特に周 囲の温度変化による材料の熱膨張、熱収縮作用が 起こってもシールを保つことができ、熱的、機械 的に強固なものができる。又、使用温度範囲も広 くなり、液中での使用も可能となるものである。

4、図面の簡単な説明

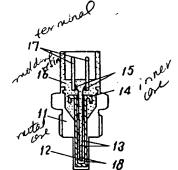
第1図は本発明の一実施例の温度検出器の縦断面図、第2図は従来の温度検出器の縦断面図である。

1 , 11 ……金属ケース、2 , 12……セラミ

っク素子、3,13……リード線、4,14…… インナーケャス、5,15……ハンダ、6,16 ……成型樹脂、7,17……端子、8,18…… ハンダ。

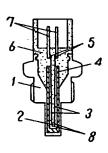
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図



11… 金属ケ-ス 12… セラミック素子 13… リード 線 14… インナ-ケ-ス 15… ハンダ 16… 成型 指 17… 端 子 18… ハンダ

第 2 図



1… 金属ケ-ス 2… セデック素 3… リード 線 4… インナ-ケ-ス 5… ハン 型 6… 成端 7… 端 8…ハン